

Title (en)

Method of making contact elements-groups for a connecting device.

Title (de)

Verfahren zur Herstellung von Kontaktelemente-Gruppen für Steckverbinder.

Title (fr)

Procédé pour la fabrication d'un groupe d'éléments-contact pour un connecteur.

Publication

EP 0645856 A1 19950329 (DE)

Application

EP 94114229 A 19940909

Priority

DE 4332636 A 19930924

Abstract (en)

Different cutting tools are alternately fitted into a stamping device in order to produce groups having a different number of contact elements (4), and different connections between the contact regions (6) and the connecting regions (9) of the contact elements (4) are thus stamped, and superfluous contacts and connections are cut away. In the case of plug connectors which are partially fitted, this method leads to economical production of different contact element groups and to a reduction in the space requirement on the connection side when installing a plug connector on a printed circuit board. <IMAGE>

Abstract (de)

Zur Herstellung von Gruppen mit einer unterschiedlichen Anzahl von Kontaktelementen (4) werden unterschiedliche Schneidwerkzeuge in eine Stanzeinrichtung eingewechselt und damit unterschiedliche Verbindungen zwischen den Kontaktbereichen (6) und den Anschlußbereichen (9) der Kontaktelemente (4) gestanzt und überflüssige Kontakte und Anschlüsse weggeschnitten. Dieses Verfahren führt bei Teilbestückung von Steckverbindern zu einer wirtschaftlichen Herstellung unterschiedlicher Kontaktelemente-Gruppen und zu einer Verringerung des anschlußseitigen Platzbedarfs beim Einbau eines Steckverbinders auf einer Leiterplatte. <IMAGE>

IPC 1-7

H01R 43/16; **H01R 23/70**

IPC 8 full level

H01R 12/55 (2011.01); **H01R 12/71** (2011.01); **H01R 43/16** (2006.01)

CPC (source: EP US)

H01R 12/724 (2013.01 - EP US); **H01R 43/16** (2013.01 - EP US); **Y10T 29/49222** (2015.01 - EP US); **Y10T 29/49224** (2015.01 - EP US)

Citation (search report)

- [A] EP 0365179 A1 19900425 - AMP INC [US]
- [A] DE 9103960 U1 19910627
- [AD] DE 9013007 U1 19901115
- [AD] EP 0422785 A2 19910417 - AMP INC [US]
- [A] KLAUS HEILMANN: "mutipin, modular, shielded and metric: the right connections with sipacs", SIEMENS COMPONENTS, vol. 8229, no. 5, September 1992 (1992-09-01), BERLIN DE, pages 36 - 39, XP000321262

Cited by

EP0891017A1; US6109933A; DE19710428A1; DE19710428B4; DE29518255U1

Designated contracting state (EPC)

BE CH DE FR GB IT LI SE

DOCDB simple family (publication)

EP 0645856 A1 19950329; **EP 0645856 B1 19971126**; DE 59404665 D1 19980108; US 5539978 A 19960730

DOCDB simple family (application)

EP 94114229 A 19940909; DE 59404665 T 19940909; US 31231494 A 19940926